

贺利氏先进封装解决方案应对超细间距封装的挑战

贺利氏半导体先进封装产品系列完美地解决了先进封装应用的最新趋势 – 小型化，散热管理和降低成本，这对于5G，人工智能，物联网，自动驾驶和其他最新技术的开发和部署至关重要。利用我们专有的 Welco®锡粉技术，我们的6号粉和7号粉锡膏确保了5G射频应用中超细间距SiP封装的最佳焊接可靠性。我们的低温锡膏也是SiP，POP或其他封装的散热管理的完美解决方案。此外，贺利氏还提供专用于 miniLED 和 MicroLED 焊接锡膏。了解我们的先进封装产品系列，将会帮助您成功的应对超细间距先进封装的各种挑战。